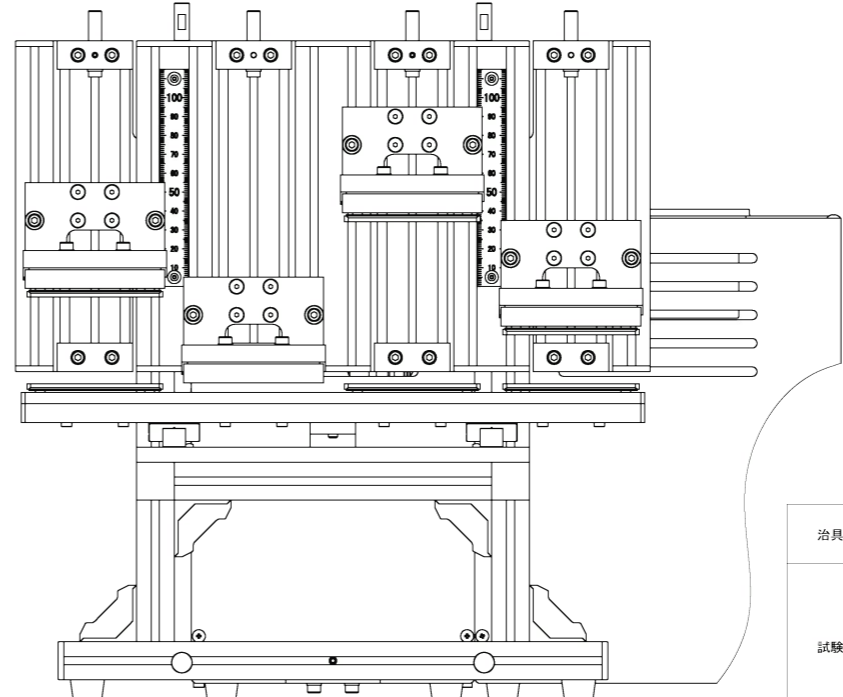
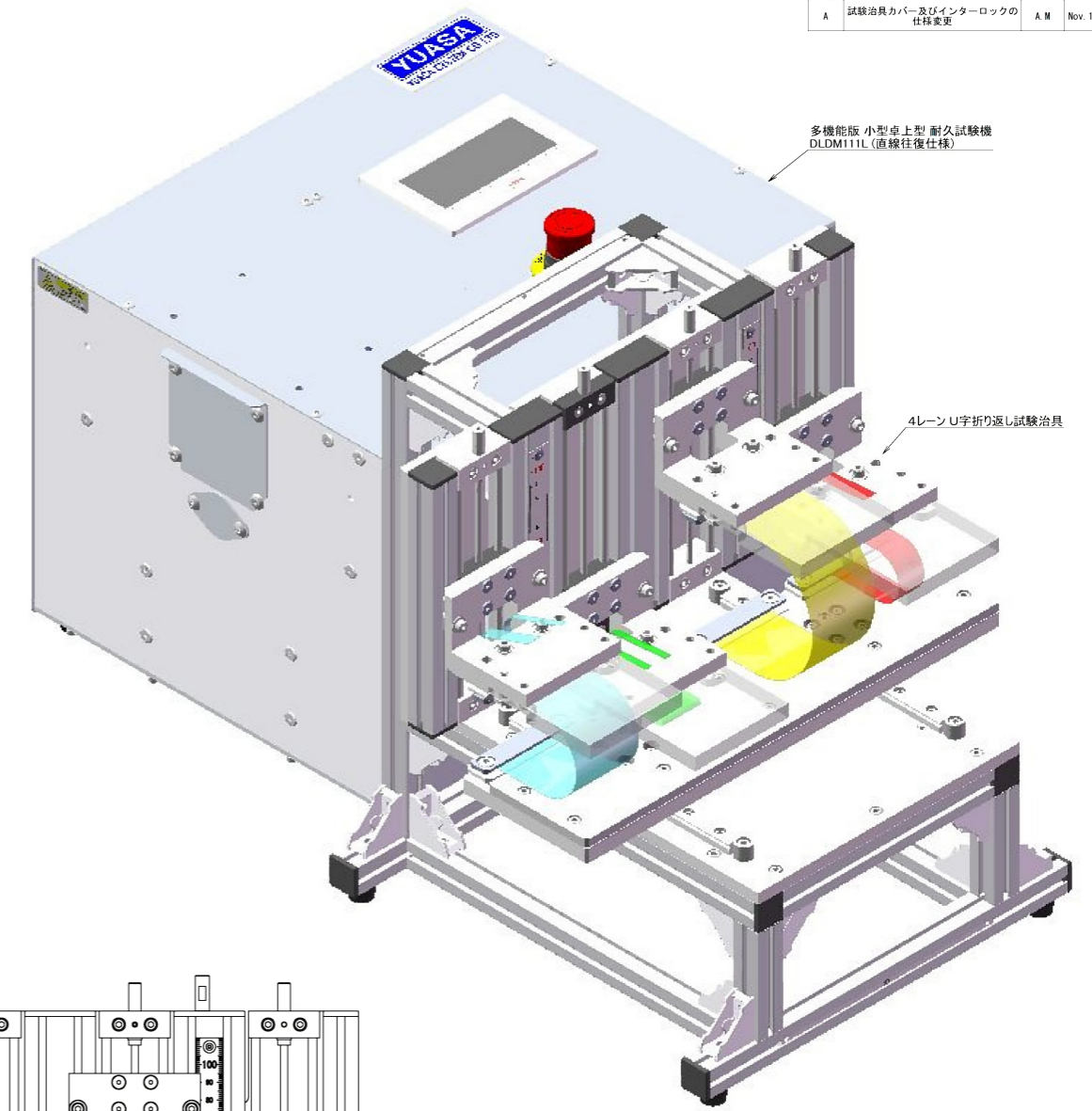
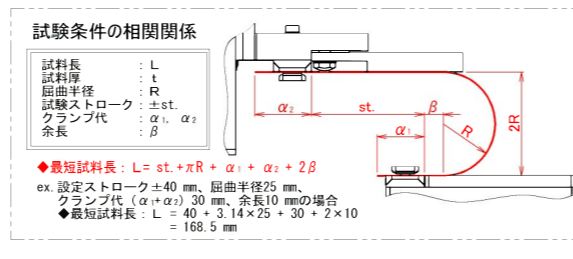
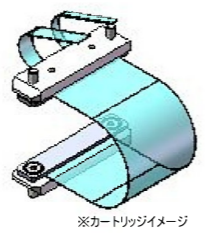
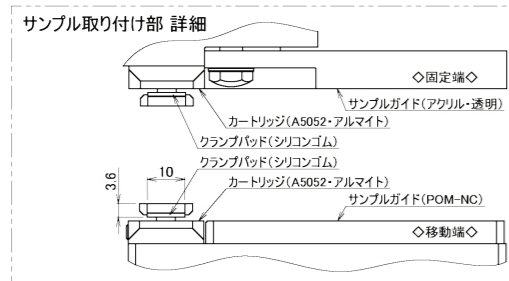
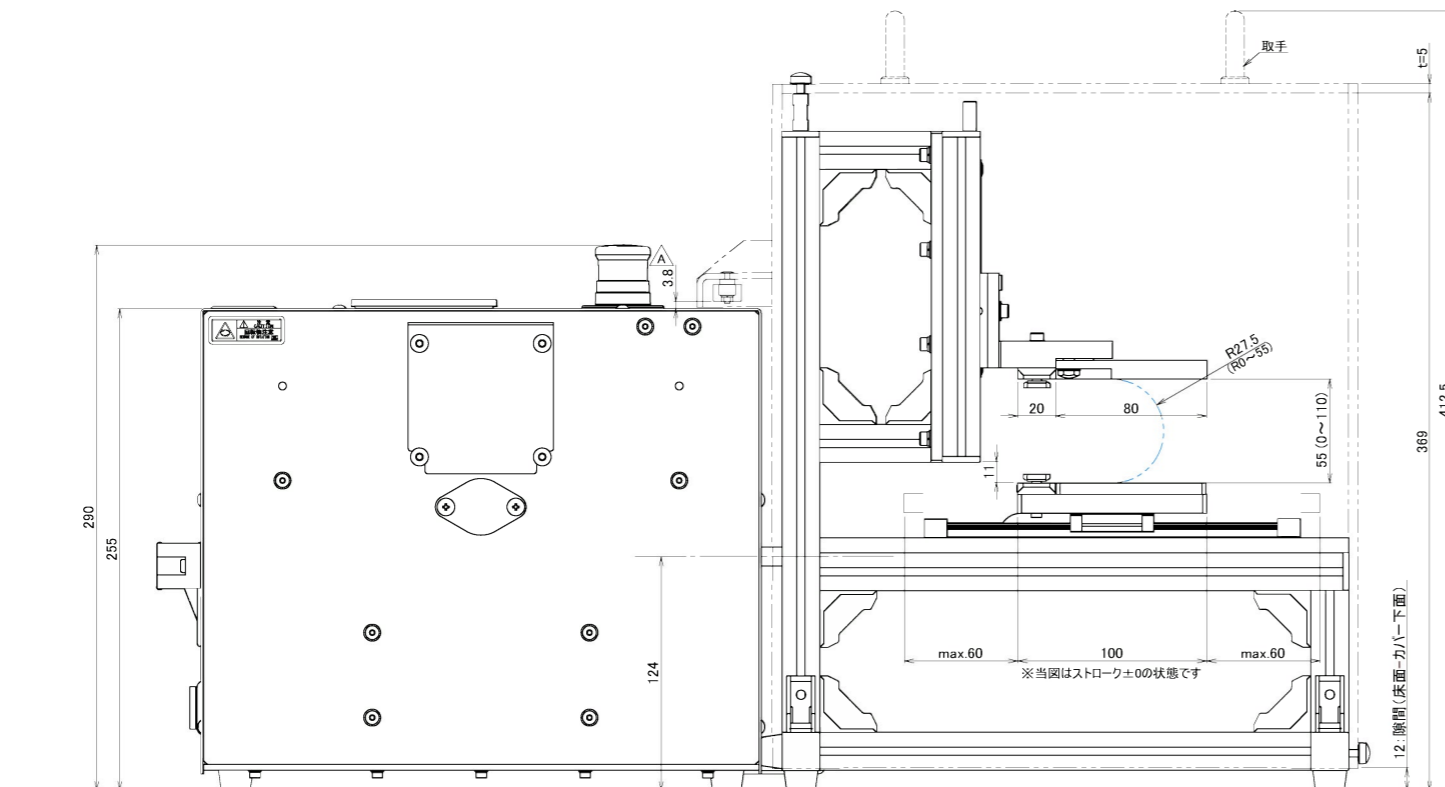
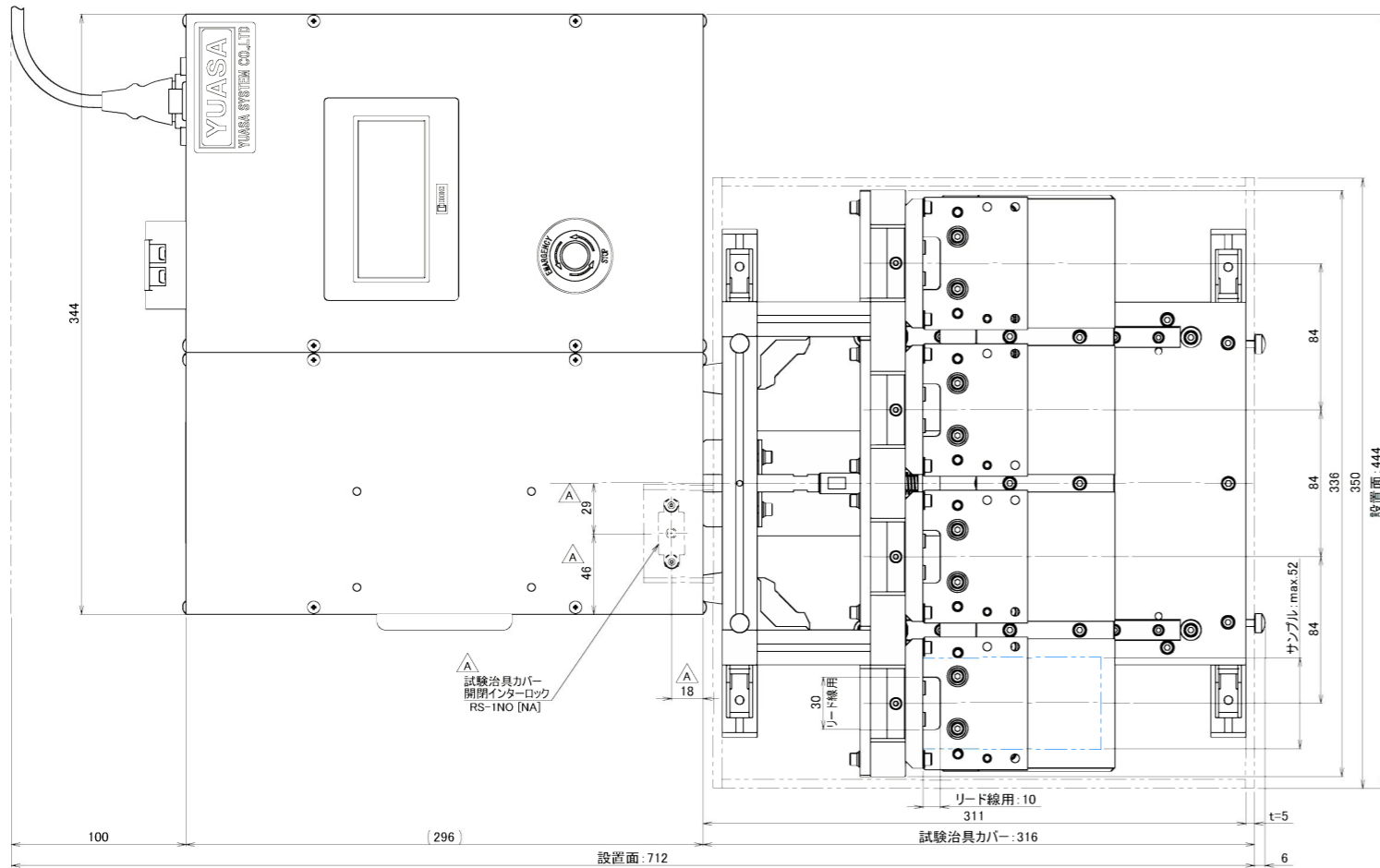


当仕様図は改良のため予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

改訂 NO.	注記 REVISION RECORD	担当 BY	日付 DATE
A	試験治具カバー及びインターロックの仕様変更	A.M	Nov. 10, 2016



治具概要	<ul style="list-style-type: none"> ・直動するクランプと固定されたクランプにより、サンプルをU字状に移動屈曲させます。 ・サンプルは4レーン分セットする事ができ、各レーン毎に屈曲半径を設定できます。 ※試験速度、試験ストロークは共通です。 ・固定側クランプを上下方向に調整し、サンプルの曲げ半径を設定します。
試験仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・最大サンプル厚 : 3 mm (レーン毎設定可能) ・最大サンプル幅 : 52 mm (レーン毎設定可能) ・最大サンプル幅 : 0~55 mm (レーン毎設定可能) ※付属クランプ使用時の最小屈曲半径(外寸)は(5×サンプル厚)mmです。 ※試験条件により、クランプ同士が干渉する場合は、粘着テープ等でサンプルを固定してください。 ・試験ストローク : 0~±60 mm (全レーン同一条件) ・試験速度 : 10~90 r/min (全レーン同一条件) ・試験速度 : サンプル専用のクランプカバー(金庫部)および、ボルトを除き、サンプルと試験治具は全て絶縁されています。
使用環境	<ul style="list-style-type: none"> ※その他、DLDM111LHの詳細仕様は、別紙を参照してください。 温度 : +5~+40°C 湿度 : 15~85%RH(結露なきこと)
質量	<ul style="list-style-type: none"> ・試験機本体 : 約 17 kg ・試験治具 : 約 9 kg ・試験治具カバー : 約 4 kg
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・試験条件を変更する際は3 mmヘキサゴンレンチを使用します。(DLDM111LHに付属されているT型レンチが使用できます)

- ◆当仕様図の構成治具
- ・ET221A01-007 : Test Jig. Sliding Folding "4"
 - ・ET136A01-004 : Floating Joint
 - ・ET209A08-001 : Joint Bracket
 - ・ET1500A03-028 : Cover, Test Jig

材質	第3角法 <th>尺</th> <td>SCALE <th>TITLE</th> <td>多機能版 小型卓上型 耐久試験機</td> </td>	尺	SCALE <th>TITLE</th> <td>多機能版 小型卓上型 耐久試験機</td>	TITLE	多機能版 小型卓上型 耐久試験機
MATERIAL	THIRD ANGLE <td>寸 <td>1:2 <td>名</td> <td>DLDM111LH</td> </td></td>	寸 <td>1:2 <td>名</td> <td>DLDM111LH</td> </td>	1:2 <td>名</td> <td>DLDM111LH</td>	名	DLDM111LH
質量	PROJECTION <td>作成日付 <td>DATE <td>DATE <td>DATE</td> </td></td></td>	作成日付 <td>DATE <td>DATE <td>DATE</td> </td></td>	DATE <td>DATE <td>DATE</td> </td>	DATE <td>DATE</td>	DATE
質量	PROJECTION <td>承認 <td>Y. Okazaki <td>承認 <td>Y. Okazaki </td></td></td></td>	承認 <td>Y. Okazaki <td>承認 <td>Y. Okazaki </td></td></td>	Y. Okazaki <td>承認 <td>Y. Okazaki </td></td>	承認 <td>Y. Okazaki </td>	Y. Okazaki
表面処理 <td>表面処理 <td>検図 <td>H. Sasaki <td>検図 <td>H. Sasaki </td></td></td></td></td>	表面処理 <td>検図 <td>H. Sasaki <td>検図 <td>H. Sasaki </td></td></td></td>	検図 <td>H. Sasaki <td>検図 <td>H. Sasaki </td></td></td>	H. Sasaki <td>検図 <td>H. Sasaki </td></td>	検図 <td>H. Sasaki </td>	H. Sasaki
SURFACE FINISH <td>SURFACE FINISH <td>設計 <td>N. Ando <td>設計 <td>N. Ando </td></td></td></td></td>	SURFACE FINISH <td>設計 <td>N. Ando <td>設計 <td>N. Ando </td></td></td></td>	設計 <td>N. Ando <td>設計 <td>N. Ando </td></td></td>	N. Ando <td>設計 <td>N. Ando </td></td>	設計 <td>N. Ando </td>	N. Ando
熱処理 <td>熱処理 <td>図 <td>ET221S001-007 <td>図 <td>ET221S001-007 </td></td></td></td></td>	熱処理 <td>図 <td>ET221S001-007 <td>図 <td>ET221S001-007 </td></td></td></td>	図 <td>ET221S001-007 <td>図 <td>ET221S001-007 </td></td></td>	ET221S001-007 <td>図 <td>ET221S001-007 </td></td>	図 <td>ET221S001-007 </td>	ET221S001-007
熱処理 <td>HEAT TREATMENT <td>番 <td> <td>番 <td> </td></td></td></td></td>	HEAT TREATMENT <td>番 <td> <td>番 <td> </td></td></td></td>	番 <td> <td>番 <td> </td></td></td>	<td>番 <td> </td></td>	番 <td> </td>	